

# RA6M2 グループ

## RA6M2 搭載静電容量タッチ評価システム Example Project

### 要旨

本書は RA6M2 搭載静電容量タッチ評価システムの Example Project に同梱されたサンプルコードについて説明します。

### 動作確認デバイス

RA6M2 (R7FA6M2AF3CFB)

### 目次

1. 概要 .....	2
1.1 機能 .....	2
2. 動作確認条件 .....	2
3. ソフトウェア仕様 .....	3
3.1 ソフトウェア構成図 .....	3
3.2 ファイル構成 .....	4
3.3 定数一覧 .....	5
3.4 列挙型一覧 .....	6
3.5 グローバル変数一覧 .....	6
3.6 関数一覧 .....	6
3.7 使用する周辺機能と端子一覧 .....	7
3.8 処理フロー .....	10
4. 静電容量タッチ設定 .....	11
4.1 タッチインタフェース構成 .....	11
4.2 構成（メソッド）の設定 .....	11
4.3 チューニング結果 .....	12
4.4 感度調整方法について .....	13
5. サポート .....	14
改訂記録 .....	15

## 1. 概要

本サンプルコードは、RA6M2 搭載静電容量タッチ評価システムで静電容量タッチ動作を確認するソフトウェアです。

e<sup>2</sup> studio で作成したプロジェクトに以下を追加しています。

- FSP Configuration で生成したコンポーネント
- QE for Capacitive Touch (以下、QE) でチューニングした静電容量タッチの設定ファイルとアプリケーション
- LED 制御アプリケーション

### 1.1 機能

以下に機能を示します。

1. 静電容量タッチ機能評価用自己容量タッチボタン/ホイール/スライダボードの全ての電極 (3つのボタン、ホイール、スライダ) を動作します。
2. 静電容量タッチボタン、スライダ、ホイールと連動して LED 制御します。
3. USB シリアルインターフェースを有効にしてシリアル通信を制御し、QE のシリアルモニタとシリアルチューニングをサポートしています。シリアルモニタとシリアルチューニングの詳細については QE のヘルプと [QE と FSP を使用した静電容量タッチアプリケーションの開発](#)の「6. 静電容量タッチアプリケーション開発手順」を参照してください。
4. CPU ボードのプッシュボタンと連動した LED 制御をします。SW2 を押すと LED2 が点灯します。SW3 を押すと LED3 が点灯します。

## 2. 動作確認条件

本アプリケーションノートのサンプルコードは、下記の条件で動作を確認しています。

表 2-1 動作確認条件

項目	内容
使用マイコン	RA6M2 (R7FA6M2AF3CFB )
動作周波数	120MHz (メインクロック発振器 12MHz、PLL 240MHz)
動作電圧	5V
使用ボード	RA6M2 搭載静電容量タッチ評価システム (製品型名 : RTK0EG0021S01001BJ) <ul style="list-style-type: none"><li>● RA6M2 CPU ボード (型名 : RTK0EG0017C01001BJ)</li><li>● 自己容量タッチボタン/ホイール/スライダボード (型名 : RTK0EG0019B01002BJ)</li></ul>
統合開発環境	e <sup>2</sup> studio Version 2023-07 (23.07.0)
C コンパイラ	GCC Arm Embedded 10.3-2021.10
静電容量式タッチセンサ対応 開発支援ツール	QE for Capacitive Touch V3.3.0
エミュレータ	Renesas E2 エミュレータ Lite
ソフトウェアパッケージ	FSP V4.6.0

図 2.1 に機器接続図を示します。

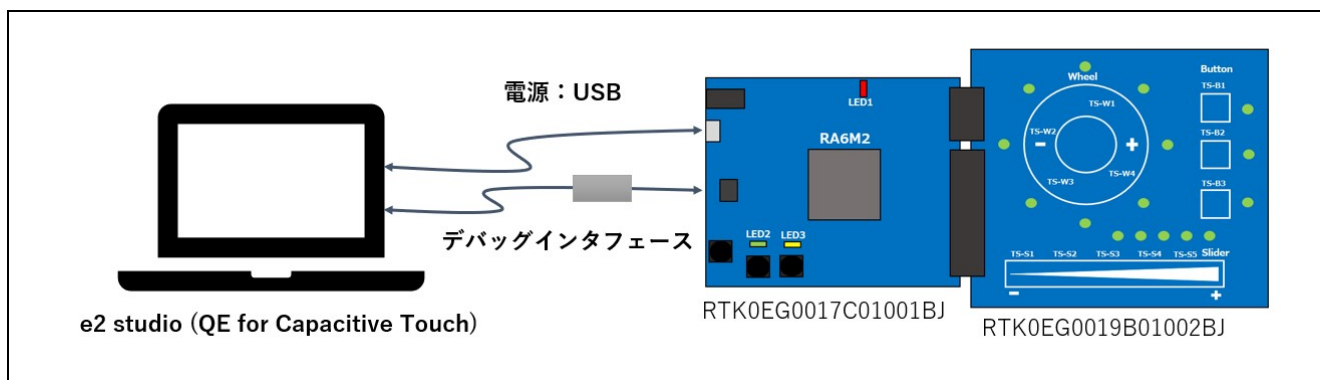


図 2.1 機器接続図

### 3. ソフトウェア仕様

#### 3.1 ソフトウェア構成図

図 3-1 に本サンプルコードのソフトウェア構成図を示します。

FSP Configuration で生成したコンポーネントを使用しています。

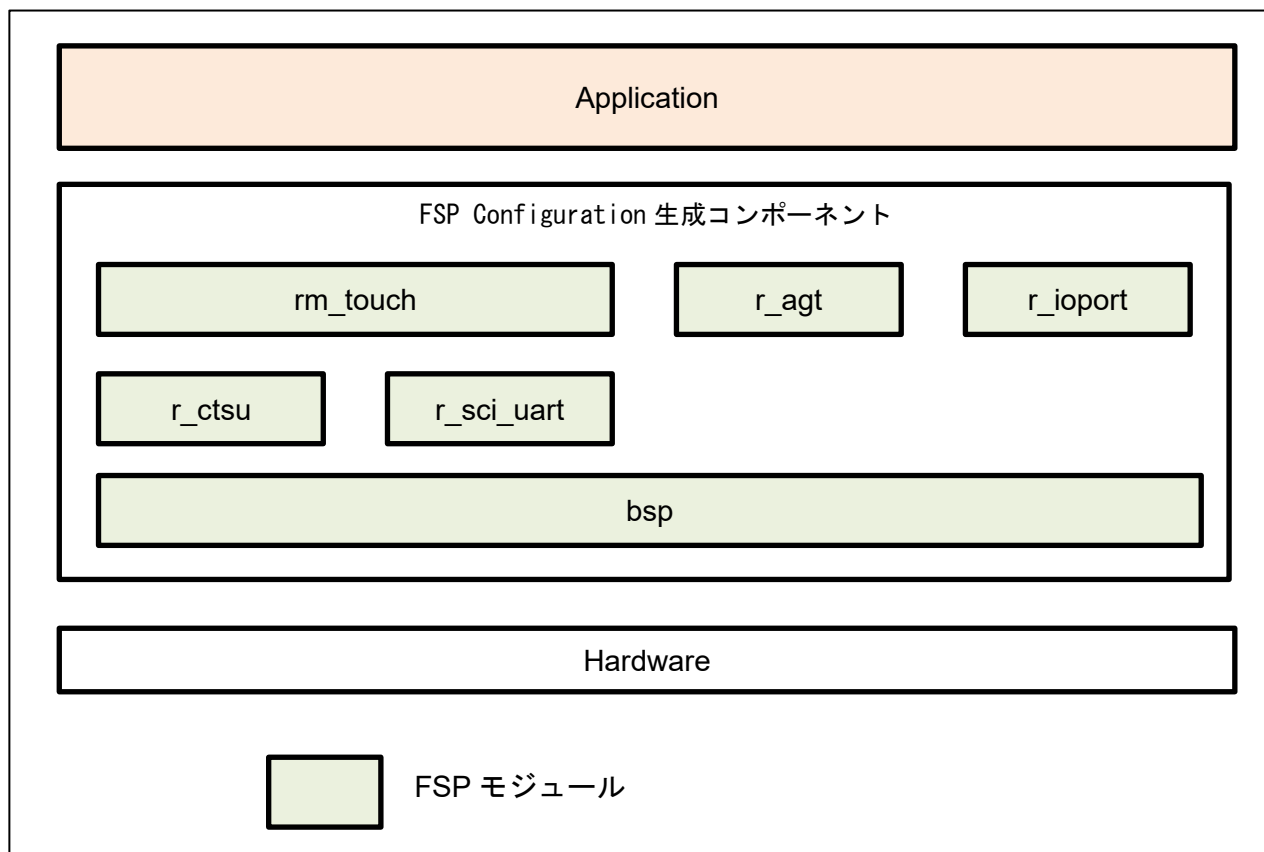


図 3-1 ソフトウェア構成図

表 3-1 にコンポーネントとバージョンの一覧を示します。コンポーネントの設定は FSP Configuration で参照してください。

表 3-1 コンポーネント一覧

#### Selected software components

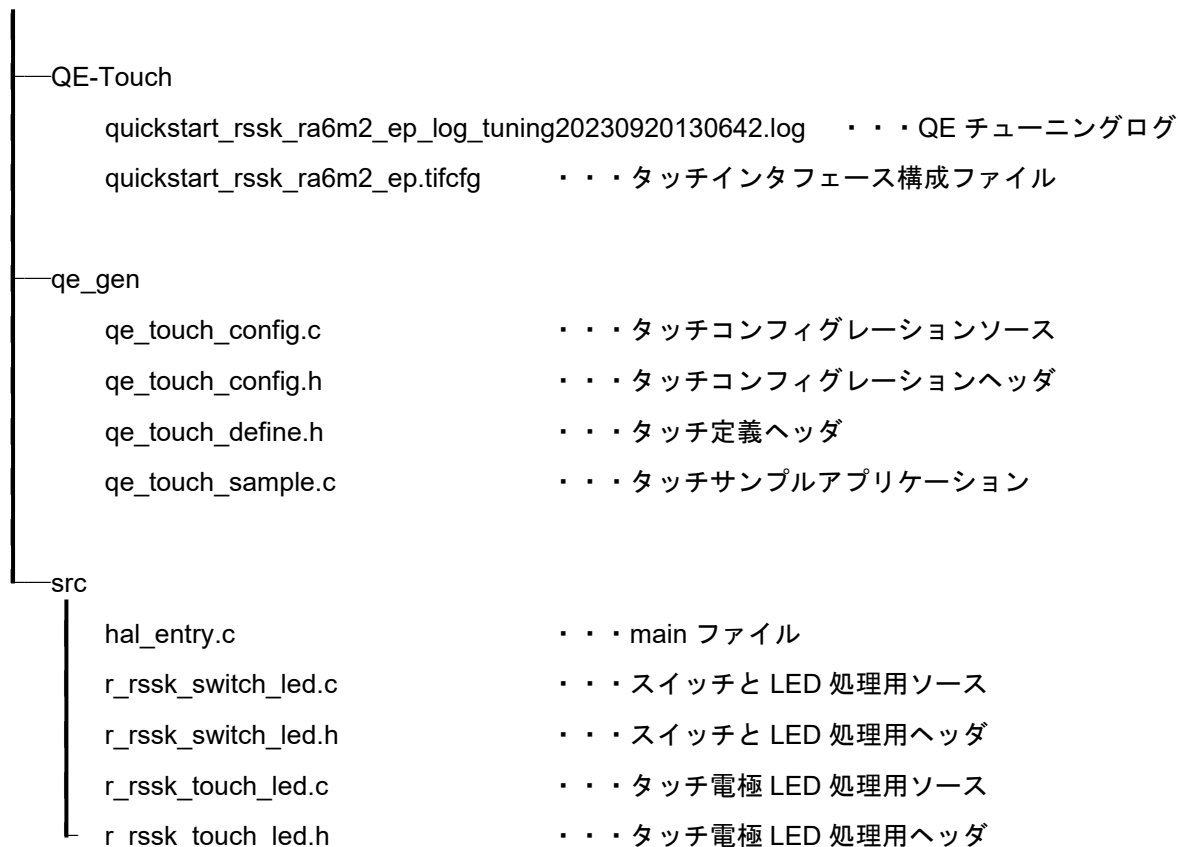
Board Support Package Common Files	v4.6.0
I/O Port	v4.6.0
Arm CMSIS Version 5 - Core (M)	v5.9.0+renesas.0.fsp.4.6.0
Board support package for R7FA6M2AF3CFB	v4.6.0
Board support package for RA6M2	v4.6.0
Board support package for RA6M2 - FSP Data	v4.6.0
Custom Board Support Files	v4.6.0
Asynchronous General Purpose Timer	v4.6.0
Capacitive Touch Sensing Unit	v4.6.0
SCI UART	v4.6.0
Touch	v4.6.0

### 3.2 ファイル構成

本サンプルコードのファイル構成を示します。

開発環境のプロジェクト構成ファイルと FSP Configuration 生成ファイルは省略しています。

quickstart\_rssk\_ra6m2\_ep



## 3.3 定数一覧

表 3-2 に定数一覧を示します。

表 3-2 定数一覧

定数名	設定値	内容
ファイル名 : qe_touch_sample.c		
TOUCH_SCAN_INTERVAL_EXAMPLE	(20U)	ソフトウェアディレイの値 [msec 単位]
ファイル名 : r_rssk_switch_led.c		
RSSK_SW2_PORT	(BSP_IO_PORT_05_PIN_02)	SW2 制御ポート定義
RSSK_SW3_PORT	(BSP_IO_PORT_05_PIN_01)	SW3 制御ポート定義
RSSK_LED2_PORT	(BSP_IO_PORT_00_PIN_06)	LED2 制御ポート定義
RSSK_LED3_PORT	(BSP_IO_PORT_00_PIN_05)	LED3 制御ポート定義
SW_EDGE_RIZE	(0x07U)	スイッチ立ち上がり判定
SW_EDGE_FALL	(0x08U)	スイッチ立ち下り判定
SW_EDGE_BIT_MASK	(0x0FU)	スイッチ状態判定マスク
RSSK_LED_ON	(0x01U)	CPU ボード LED 点灯
RSSK_LED_OFF	(0x00U)	CPU ボード LED 消灯
ファイル名 : r_rssk_touch_led.c		
LED_COL0	(BSP_IO_PORT_01_PIN_03)	COL0 制御ポート定義
LED_COL1	(BSP_IO_PORT_05_PIN_03)	COL1 制御ポート定義
LED_COL2	(BSP_IO_PORT_05_PIN_04)	COL2 制御ポート定義
LED_COL3	(BSP_IO_PORT_05_PIN_06)	COL3 制御ポート定義
LED_ROW0	(BSP_IO_PORT_00_PIN_08)	ROW0 制御ポート定義
LED_ROW1	(BSP_IO_PORT_00_PIN_07)	ROW1 制御ポート定義
LED_ROW2	(BSP_IO_PORT_00_PIN_14)	ROW2 制御ポート定義
LED_ROW3	(BSP_IO_PORT_00_PIN_09)	ROW3 制御ポート定義
LED_COL_MAX	(4U)	COL 信号数
LED_ROW_MAX	(4U)	ROW 信号数
LED_COL_OFF	(BSP_IO_LEVEL_LOW)	COL 信号 OFF
LED_COL_ON	(BSP_IO_LEVEL_HIGH)	COL 信号 ON
LED_ROW_OFF	(BSP_IO_LEVEL_HIGH)	ROW 信号 OFF
LED_ROW_ON	(BSP_IO_LEVEL_LOW)	ROW 信号 ON
SLIDER_LED_NUM	(5U)	スライダ LED 数
SLIDER_RESOLUTION	(100U)	スライダタッチ結果最大値
WHEEL_LED_NUM	(8U)	ホイール LED 数
WHEEL_LED_MSB	(1U << (WHEEL_LED_NUM - 1))	ホイール制御ビット MSB
WHEEL_RESOLUTION_DEGREE	(360U)	ホイールタッチ結果最大値 [単位 : 度]
WHEEL_POSITION_OFFSET_DEGREE	(112U)	ホイールタッチ位置オフセット[単位 : 度]
ALL_LED_NUM	(16U)	電極ボード LED 数
LED_TEST_INTERVAL	(100U)	LED 点灯インターバル時間

### 3.4 列挙型一覧

表 3-3 に rsk\_sw\_status\_t の列挙型を示します。

表 3-3 rsk\_sw\_status\_t

メンバ	値	説明
RSSK_SW_OFF	0x00	スイッチ OFF 状態
RSSK_SW_ON	0x01	スイッチ ON 状態

### 3.5 グローバル変数一覧

表 3-4 にグローバル変数を示します。

表 3-4 グローバル変数

変数名	型	説明
ファイル名 : r_rsk_touch_led.c		
g_led_column[]	bsp_io_port_pin_t	タッチ電極 LED 駆動ポート行格納配列
g_led_row[]	bsp_io_port_pin_t	タッチ電極 LED 駆動ポート列格納配列
g_led_drive_colmun	uint8_t	タッチ電極 LED 駆動情報
g_button_idx[]	uint8_t	ボタンインデックス格納配列

### 3.6 関数一覧

表 3-5 に関数の一覧を示します。

表 3-5 関数一覧

関数名	処理概要
ファイル名 : qe_touch_sample.c	
qe_touch_main	Main function
r_rsk_initialize	静電容量タッチ評価システムの LED 初期化処理
r_rsk_led_test	静電容量タッチ評価システムの LED テスト処理
timer0_callback	AGT 割り込みコールバック
ファイル名 : r_rsk_switch_led.c	
r_rsk_switch_led_control	CPU ボード LED 制御処理
r_rsk_led2_on	CPU ボード LED2 点灯
r_rsk_led2_off	CPU ボード LED2 消灯
r_rsk_led3_on	CPU ボード LED3 点灯
r_rsk_led3_off	CPU ボード LED3 消灯
rsk_get_sw2_status	CPU ボード SW2 状態確認
rsk_get_sw3_status	CPU ボード SW3 状態確認
ファイル名 : r_rsk_touch_led.c	
r_rsk_touch_led_test	電極ボード LED テスト処理
r_rsk_touch_led_control	電極ボード LED 制御処理
create_led_bitstring_button	電極ボード LED 制御(ボタン)
create_led_bitstring_wheel	電極ボード LED 制御(ホイール)
create_led_bitstring_slider	電極ボード LED 制御(スライダ)

### 3.7 使用する周辺機能と端子一覧

本サンプルソフトウェアで使用する周辺機能一覧を表 3-6 に、使用端子一覧を表 3-7 に、未使用端子と処置の一覧を表 3-8 に示します。

表 3-6 使用する周辺機能一覧

周辺機能	用途
CTSU	CTSU 計測
SCI	QE のシリアルモニタリング対応
AGT	LED 制御のトリガ
IOPORT	LED 制御

表 3-7 使用端子一覧

ピン番号	端子名	I/O	用途
45	TSCAP	I	CTSU 計測
44	TS00	I/O	
42	TS01	I/O	
41	TS02	I/O	
36	TS03	I/O	
34	TS05	I/O	
33	TS06	I/O	
32	TS07	I/O	
31	TS08	I/O	
30	TS09	I/O	
29	TS10	I/O	
26	TS13	I/O	
25	TS14	I/O	
24	TS15	I/O	
23	TS16	I/O	
22	TS17	I/O	
88	P613/TXD7	O	
89	P614/RXD7	I	
114	P501	I	LED 制御(CPU ボード)
115	P502	I	
135	P005	O	
134	P006	O	
133	P007	O	LED 制御(電極ボード)
132	P008	O	
131	P009	O	
124	P014	O	
119	P506	O	
117	P504	O	
116	P503	O	
105	P103	O	

表 3-8 未使用端子と処置の一覧

ピン番号	端子名	I/O	未使用の処置
14	VBATT	I	バックアップ電源端子
15	VCL0	-	コンデンサ(0.1uF)を介し、グランドへ接続
16	XCIN	I	XCOUT と XCIN の間には、水晶振動子を接続
17	XCOU	O	
19	XTAL	O	EXTAL 端子を通じて外部クロック信号の入力が可能
20	EXTAL	I	
37	VSS_USB	I	グランド端子
38	USB_DM	I/O	USB バスの D-端子に接続
39	USB_DP	I/O	USB バスの D+端子に接続
40	VCC_USB	I	電源端子
55	RES	I	リセット回路へ接続
56	MD	I	リセット解除時の動作モード遷移中に信号を変更しない
92	VCL	-	コンデンサ(0.1uF)を介し、グランドへ接続
125	VREFL	I	アナログ基準グランド端子
126	VREFH	I	アナログ基準電圧端子
127	AVCC0	I	VCC 端子と同じ電圧を供給
128	AVSS0	I	VSS 端子と同じ電圧を供給
129	VREFL0	I	アナログ基準グランド端子
130	VREFH0	I	アナログ基準電圧端子
18	VSS	I	グランド端子。システムの電源(0V)に接続
48			
67			
82			
91			
100			
112			
122			
141			
21			
49			
68	VCC	I	電源端子。コンデンサ(0.1uF)を介し、電源に接続
81			
90			
99			
111			
121			
142			
上記以外の端子			
		-	Low 出力



FSP Configuration を用いた周辺機能の設定を以下に示します。

- CTSU (CTSU 計測)

タッチ計測を行うために CTSU を使用します。CTSU の設定はデフォルト設定となっています。

- SCI

QE for Capacitive Touch のシリアルモニタリング対応に SCI を使用します。SCI の設定を表 3-9 に示します。

表 3-9 SCI 設定

項目	設定
使用するモード	Asynchronous UART
使用するチャンネル	7

- AGT

LED 制御のトリガ用に AGT を使用します。AGT の設定を表 3-10 に示します。

表 3-10 AGT 設定

項目	設定
周期	5ms
使用するチャンネル	0

- IOPORT

LED 制御用に IOPORT を使用します。IOPORT の設定はデフォルト設定となっています。

## 3.8 処理フロー

本サンプルコードの処理フローを示します。

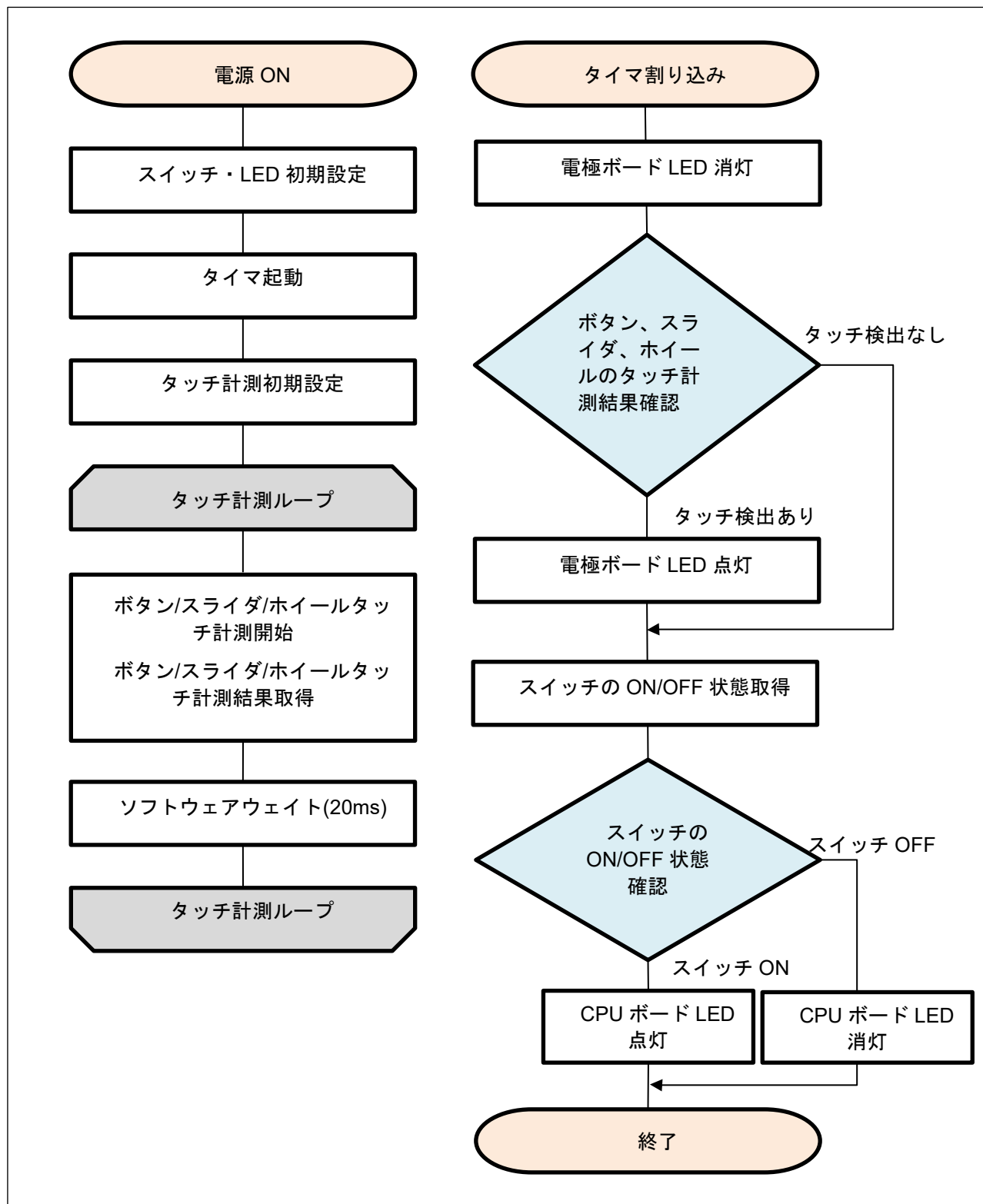


図 3-2 処理フロー（自己容量タッチボタン／ホイール／スライダボード）

## 4. 静電容量タッチ設定

本サンプルコードのタッチインタフェース構成、構成（メソッド）の設定とチューニング結果を示します。QE のチューニング機能を使用しています。

### 4.1 タッチインタフェース構成

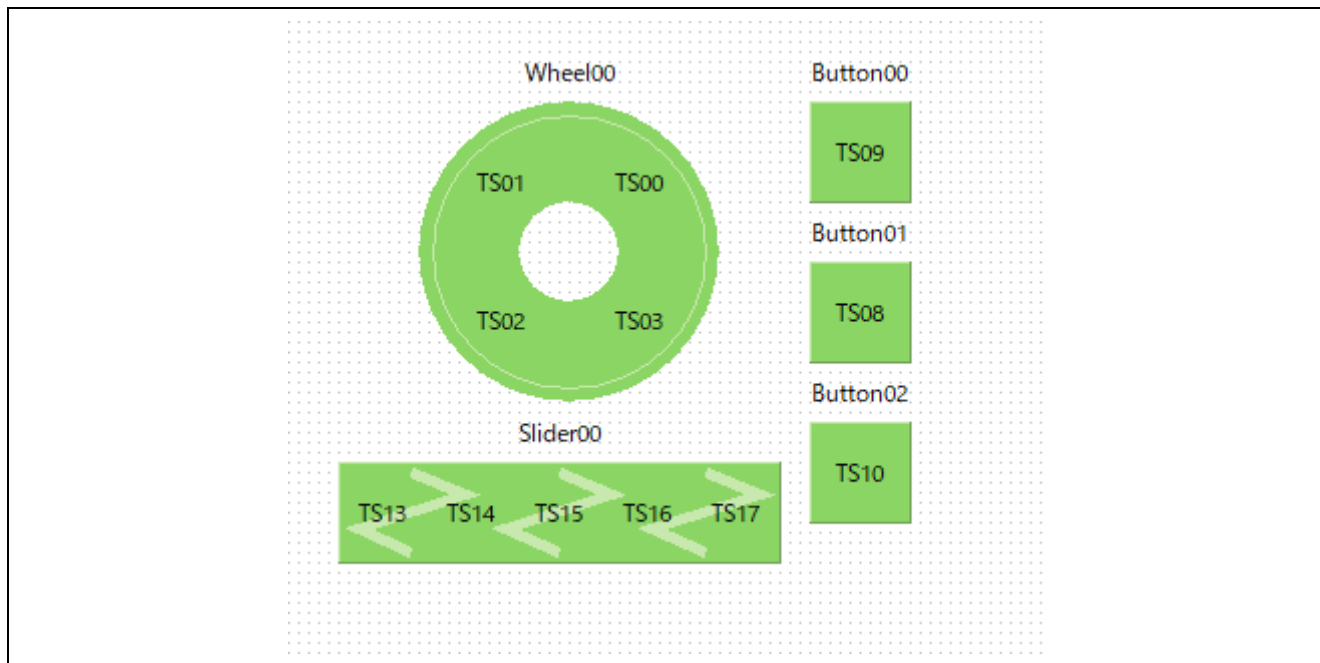


図 4-1 タッチインタフェース構成画面（自己容量タッチボタン／ホイール／スライダボード）

### 4.2 構成（メソッド）の設定

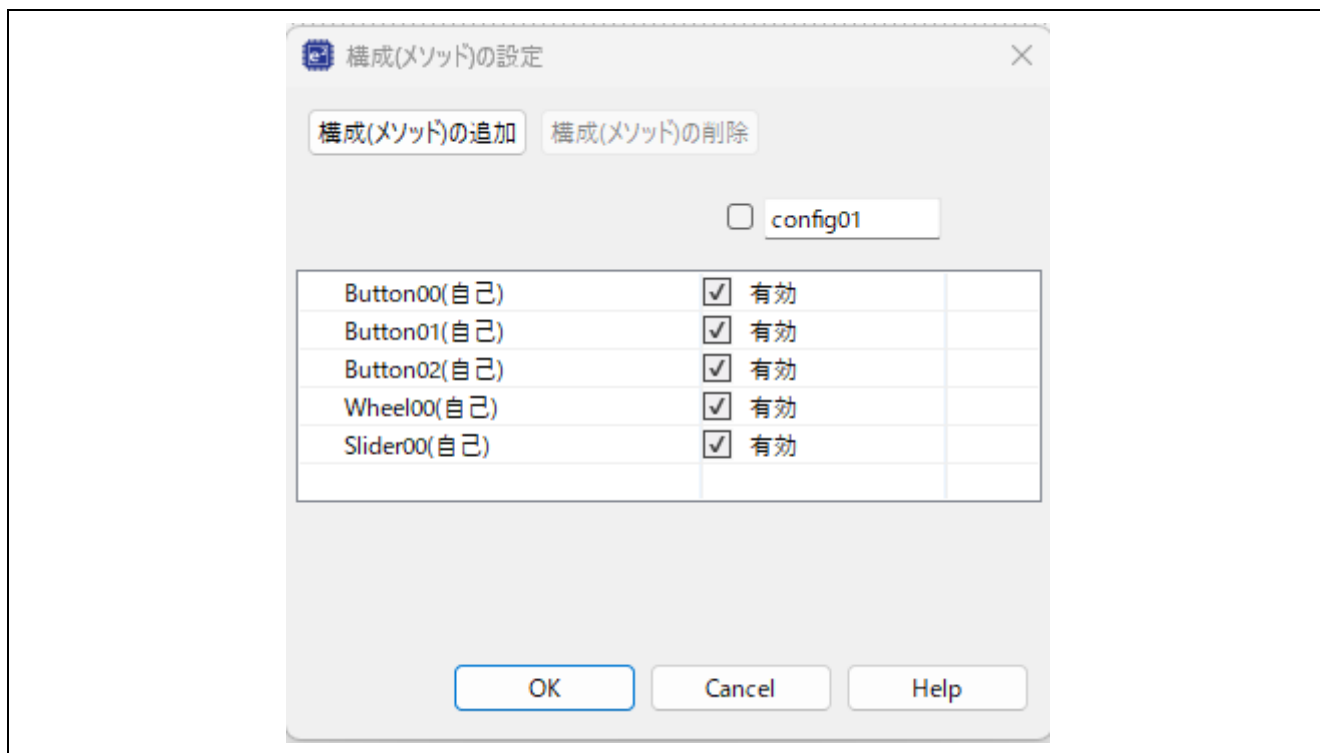


図 4-2 構成（メソッド）の設定画面

### 4.3 チューニング結果

QE チューニングでのチューニング結果を示します。本プログラムは結果一覧に示される設定値で動作しています。

結果一覧の値は QE チューニング時の動作環境に依存するため、再度 QE チューニングするとこれらの値が変化する可能性があります。

表 4-1 QE チューニング結果一覧（自己容量タッチボタン／ホイール／スライダボード）

メソッド	名前	タッチセンサ	寄生容量 [pF]	ドライブパルス周波数 [MHz]	閾値	計測時間 [ms]	so	snum	sdpa
config01	Button00	TS09	21.854	1.768 (BASE:1.875)	1364	0.594	0x0E1	0x03	0x07
config01	Button01	TS08	19.918	1.768 (BASE:1.875)	1051	0.594	0x0C8	0x03	0x07
config01	Button02	TS10	20.019	1.768 (BASE:1.875)	1053	0.594	0x0C9	0x03	0x07
config02	Slider00	TS13	16.939	0.943 (BASE:1.0)	598	0.592	0x02D	0x01	0x0E
config02	Slider00	TS14	18.565	0.943 (BASE:1.0)	598	0.592	0x038	0x01	0x0E
config02	Slider00	TS15	18.919	0.943 (BASE:1.0)	598	0.592	0x03B	0x01	0x0E
config02	Slider00	TS16	19.746	0.943 (BASE:1.0)	598	0.592	0x041	0x01	0x0E
config02	Slider00	TS17	22.998	0.943 (BASE:1.0)	598	0.592	0x054	0x01	0x0E
config03	Wheel00	TS01	24.658	0.943 (BASE:1.0)	677	0.592	0x064	0x01	0x0E
config03	Wheel00	TS00	24.732	0.943 (BASE:1.0)	677	0.592	0x063	0x01	0x0E
config03	Wheel00	TS03	25.791	0.943 (BASE:1.0)	677	0.592	0x054	0x01	0x0E
config03	Wheel00	TS02	22.482	0.943 (BASE:1.0)	677	0.592	0x06C	0x01	0x0E

so : センサオフセット設定の変数  
snum : 計測期間設定の変数  
sdpa : クロック分周設定の変数

#### 4.4 感度調整方法について

ボタンの感度調整は QE for Capacitive Touch で行います。感度調整方法には以下の方法があります。

- QE for Capacitive Touch のチューニング機能を使用した方法  
QE for Capacitive Touch の「CapTouch ワークフロー(QE)」から、チュートリアルに従って実施してください。
- QE for Capacitive Touch のモニタリング機能を使用したリアルタイム変更方法  
QE for Capacitive Touch の Cap Touch パラメーター一覧を表示し、以下の手順にて調整します。
  1. 調整したいボタンに対応したタッチ I/F を選択します。
  2. [モニタリングを有効にする]をクリックし、モニタリングを開始します。
  3. モニタリングが有効になると、CapTouch パラメーター一覧の項目が表示されます。
  4. [リアルタイムにターゲットボードへ書き込む]をクリックし、有効にします。
  5. [タッチ閾値]の値を変更します。
  6. 4 を繰り返して、感度調整を行います。
  7. 感度調整の完了後に、以下の手順にて調整結果をソースコードへ反映します。
  8. [パラメータファイルを生成する]をクリックします。
  9. IDE(e<sup>2</sup> studio 等)でプロジェクトをビルドします。
  10. IDE(e<sup>2</sup> studio 等)で MCU へプログラムを書き込みます。

上記の手順番号 1~3、5、8 の設定は、の①~③、⑤、⑧で操作します。

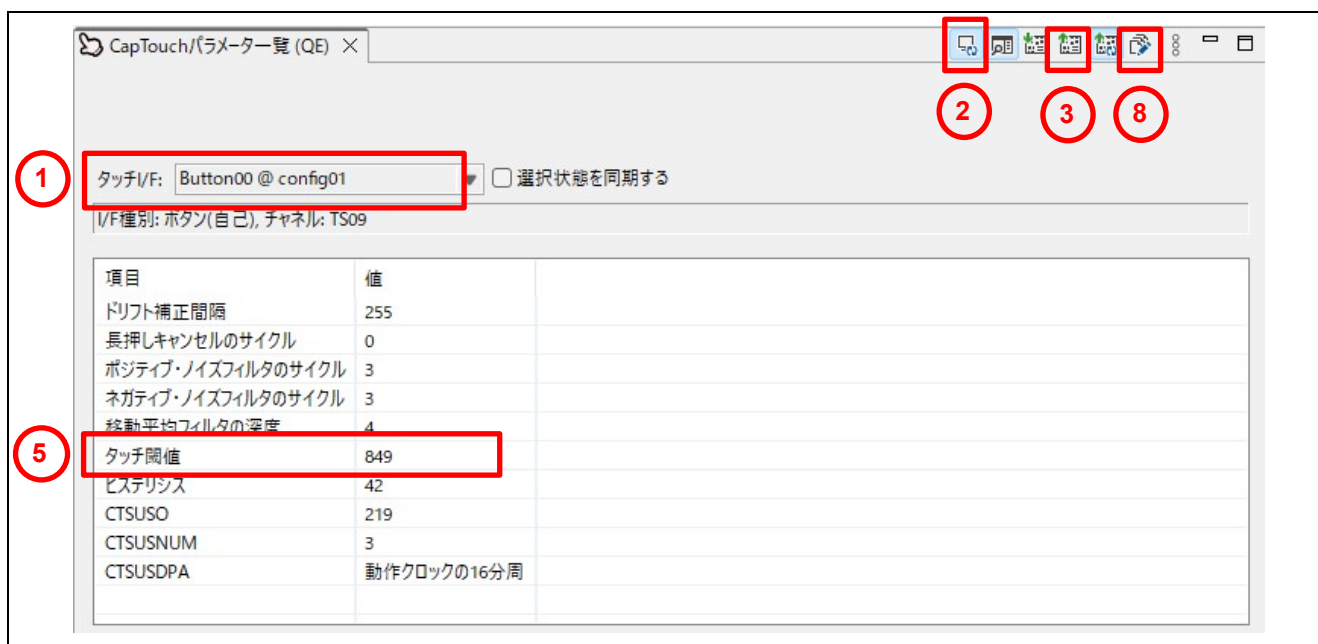


図 4-3 モニタリング機能を使用した感度調整画面

- 手動によるコードを変更する方法  
qe\_touch\_config.c 内の、構造体変数 g\_qe\_touch\_button\_cfg\_config01、g\_qe\_touch\_slider\_cfg\_config01、g\_qe\_touch\_wheel\_cfg\_config01 のメンバ変数を変更することで調整が可能です。  
変更する変数は以下になります。
  - ・ threshold : タッチ判定の閾値

## 5. サポート

静電容量タッチに関する情報、ツールやドキュメントのダウンロード、技術サポートについては下記のウェブサイトを参照してください。

RA6M2 搭載静電容量タッチ評価システム

<https://www.renesas.com/rssk-touch-ra6m2>

RA ファミリ QE と FSP を使用した静電容量タッチアプリケーションの開発(R01AN4934)

[renesas.com/jp/ja/document/apn/using-qe-and-fsp-develop-capacitive-touch-applications?r=1398061](https://www.renesas.com/jp/ja/document/apn/using-qe-and-fsp-develop-capacitive-touch-applications?r=1398061)

QE for Capacitive Touch

[renesas.com/qe-capacitive-touch](https://www.renesas.com/qe-capacitive-touch)

Renesas サポート

[renesas.com/support](https://www.renesas.com/support)

## 改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Nov.16.20	—	初版発行
2.00	Dec.25.23	—	FSP v4.6.0 のサポート QE for Capacitive Touch V3.3.0 のサポート ソフトウェア仕様を追加

## 製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

### 1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

### 2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

### 3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れしないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

### 4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

### 5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

### 6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 $V_{IL}$  (Max.) から  $V_{IH}$  (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 $V_{IL}$  (Max.) から  $V_{IH}$  (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

### 7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

### 8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違えば、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。



## ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含まれます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、変更、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、変更、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通管制（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

- 当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。
7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア/ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限られません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア/ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
  8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
  9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
  10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
  11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
  12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものいたします。
  13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
  14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

## 本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレストシア）

[www.renesas.com](http://www.renesas.com)

## お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

[www.renesas.com/contact/](http://www.renesas.com/contact/)

## 商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。